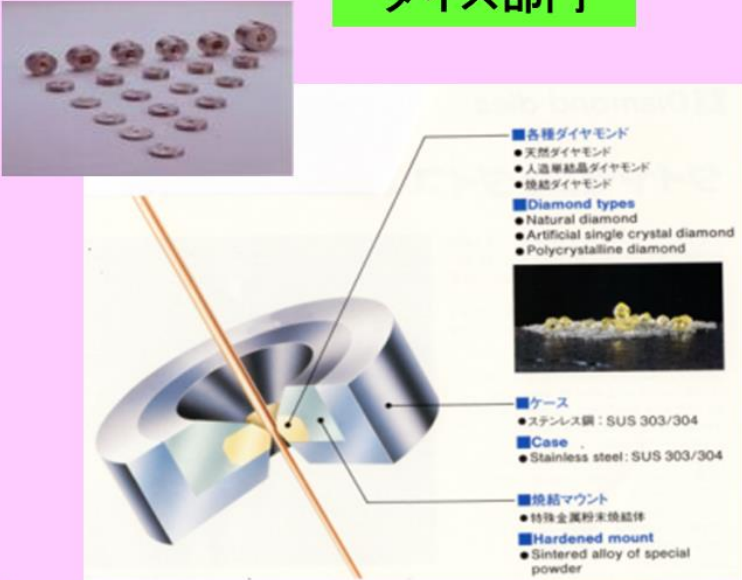


我们的产品

ダイス部門



各種ダイヤモンド

- 天然ダイヤモンド
- 人工単結晶ダイヤモンド
- 多結晶ダイヤモンド

Diamond types

- Natural diamond
- Artificial single crystal diamond
- Polycrystalline diamond

ケース

- ステンレス鋼: SUS 303/304

Case

- Stainless steel: SUS 303/304

焼結マウント

- 特殊金属粉末焼結体

Hardened mount

- Sintered alloy of special powder

高精度拉丝模具用于键合丝，极细不锈钢丝等极细线材的拉拔。最终产品主要应用于半导体，LED，打印机等领域。市场占有率 > 70%

ダイス部門

ボンディングワイヤ

(写真は線径 25 μm)



GMH-2 φ 25 μm
 Bonder : Shinkawa UTC-400BI
 Loop Length Loop Height
 2nd : 3.5mm 2nd : 700 μm
 1st : 1.0mm 1st : 110 μm

銅線



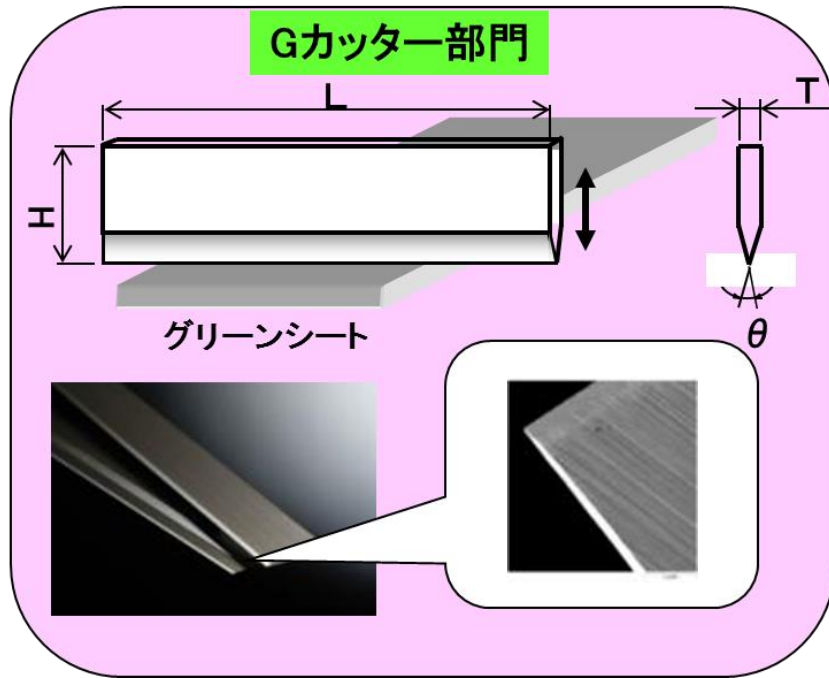
- ワイヤーハーネス
- モーター用巻き線 等

ステンス線

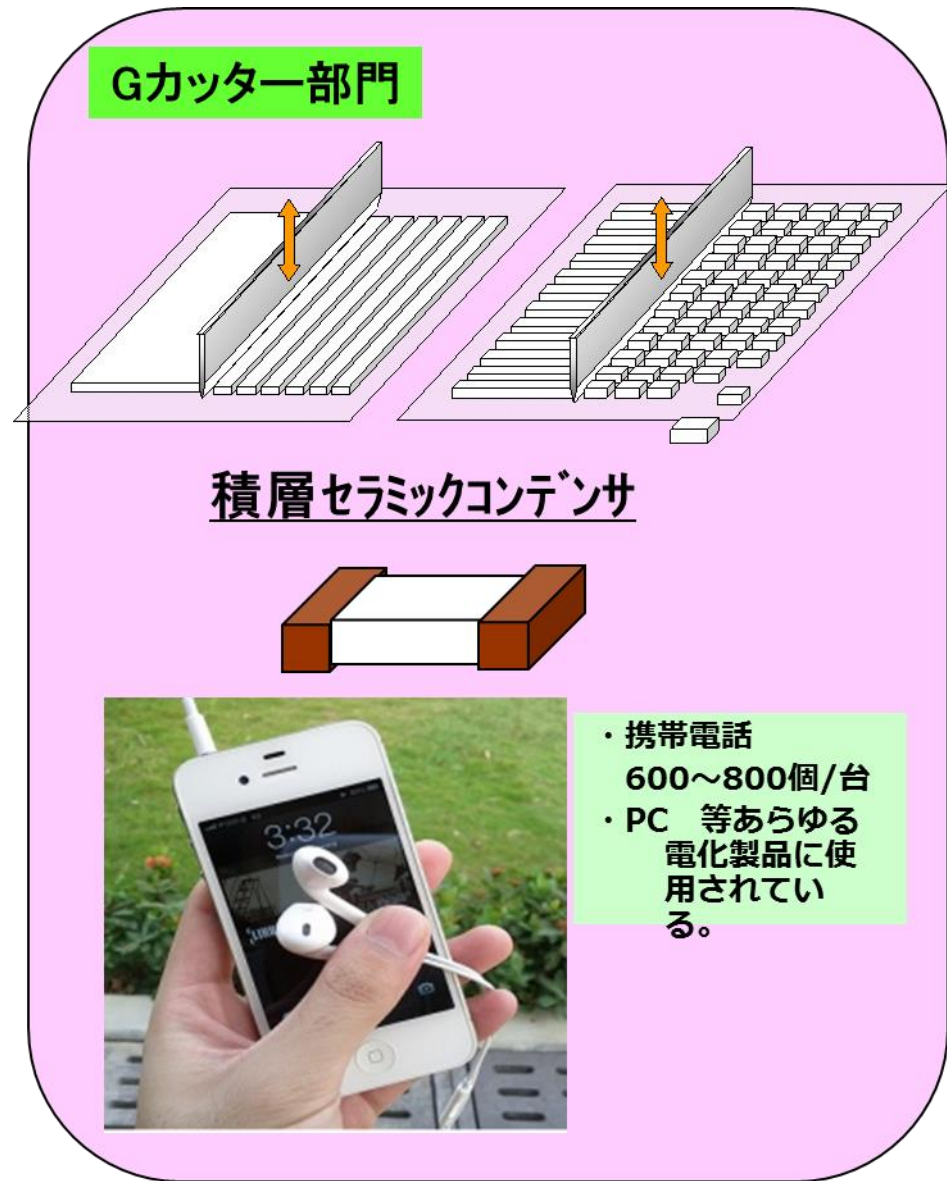


電極材 メッシュ
 スクリーン印刷

我们的产品



高精度钨钢刀片主要用于切割陶瓷电容
陶瓷电容在智能手机中被大量使用
约 800 个/台
我司刀片生产的陶瓷电容的应用品牌
苹果, OPPO, VIVO 等



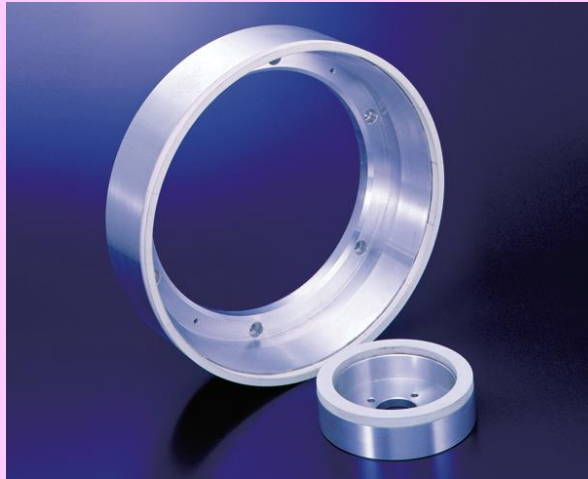
我们的产品

研削工具部門

超硬/サ-メット
切削工具用



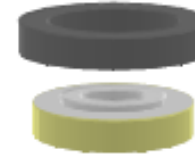
PCD/PcBN
切削工具用



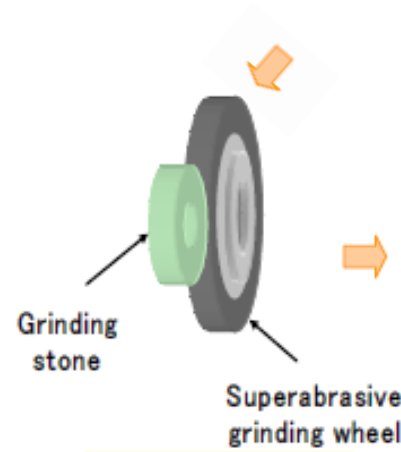
リング



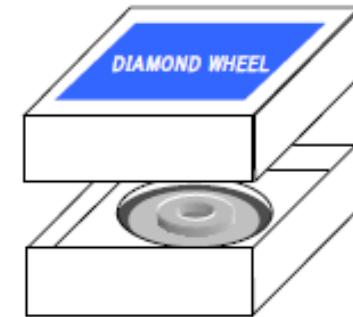
ボディ



接着



ドレッシング



検査・梱包